

# ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ 実験動画で学ぶエッチング工程 ～ウェットエッチング・ドライエッチング～

※本配信は昨年度に配信した技術セミナー「MEMS 微細加工入門・2 エッチング」と同等の内容です。

## 視聴期間

2023年11月29日（水）～2023年12月5日（火）

- ◆上記視聴期間内であれば何回でも視聴可能です。
- ◆申込方法、視聴環境については次頁をご確認ください。

講義時間 約60分

受講料 1,000円

定員 20名

### 『エッチング技術』をこれから学びたい方へ

MEMSなどの電子産業においては、各種エッチング技術を用いたシリコン基板の3次元構造形成が行われております。これらの加工は、高度な3次元デバイスを実現する上で欠かせないものとなっています。

本講習では、反応性イオンエッチング（RIE）やシリコン深堀エッチング等の各種ドライエッチング技術、機械加工では困難な高精度の特殊形状を安価に得られるシリコン異方性エッチング（ウェットエッチング）についての解説を交えて実験室レベルの工程を紹介することで、エッチング技術の理解を深めていきます。

これからエッチング技術を学びたい方をはじめとして、エッチング技術を活用されたい方、都産技研のエッチング設備のご利用をご検討されている方などご参加をお待ちしております。

※配信動画の著作権は都産技研に帰属します。録音・録画はご遠慮ください。

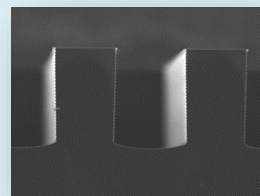
## 講座内容

配信時間	科目	講師
60分	1. 半導体工程によるナノ・マイクロスケールの微細加工 2. エッチングの概要 3. ウェットエッチングの工程 4. ドライエッチングの工程 5. 加工事例の紹介 (ピラミッドアレイ、片持ち梁アクチュエータ)	東京都立産業技術研究センター 電気技術グループ 宮下惟人 (音声読み上げソフトによる解説)

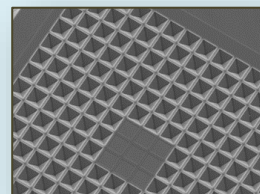


マスコットキャラクター テリン

### <加工パターンの例>



Si 深堀り・トレンチ構造



単結晶 Si  
逆ピラミッドアレイ

### 募集要項

- <応募資格> 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
- <申込締切> 2023年11月15日（水）  
※定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。
- <申込方法> 都産技研ウェブサイト <https://www.iri-tokyo.jp/seminar/231129-1205.html> の Web 申込フォームからお申し込みください。



- 申込時には、  
「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター技術支援事業ご利用約款  
第1章 総論および第7章 技術セミナー・講習会オンラインでの開催」  
(<https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/15778.pdf>)の条文について  
ご承諾の上お申込みをお願いします。



- <受講可否> 受講予定者には受講料払込書を郵送します。  
定員などの関係で受講をお断りする場合は、電話・電子メールなどにてご連絡いたします。

### 参加方法

- 受講料の入金確認後、本オンデマンド配信の視聴期間初日までに E メールで視聴 URL およびパスワードを申込者に送付いたします。  
テキストは、E メールまたは郵送にて送付いたします。  
**※受講者以外の第三者が上記ログイン情報を使用することはできません。  
また、上記ログイン情報を貸与、譲渡、売買などすることはできません。**
- 視聴環境(パソコンなど)は、お客さまにてご用意ください。  
お客様の視聴環境に関する問い合わせには、お答えできません。
- Web ブラウザは、Microsoft® Edge<sup>※1</sup> または Google chrome<sup>TM※2</sup> をご使用ください。  
<sup>※1※2</sup> Microsoft® Edge はマイクロソフト社の登録商標で、Google chrome<sup>TM</sup> はグーグル社の商標です。

### 問い合わせ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係  
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308 FAX:03-5530-2318  
メール：[kenshu@iri-tokyo.jp](mailto:kenshu@iri-tokyo.jp)

